

FDP6670AL/FDB6670AL

N-Channel Logic Level PowerTrench[®] MOSFET

General Description

This N-Channel Logic Level MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers.

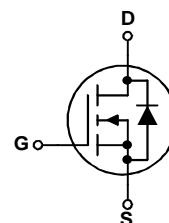
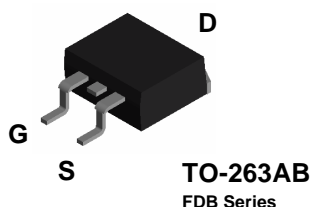
These MOSFETs feature faster switching and lower gate charge than other MOSFETs with comparable $R_{DS(ON)}$ specifications.

The result is a MOSFET that is easy and safer to drive (even at very high frequencies), and DC/DC power supply designs with higher overall efficiency.

It has been optimized for low gate charge, low $R_{DS(ON)}$ and fast switching speed.

Features

- 80 A, 30 V $R_{DS(ON)} = 6.5 \text{ m}\Omega @ V_{GS} = 10 \text{ V}$
 $R_{DS(ON)} = 8.5 \text{ m}\Omega @ V_{GS} = 4.5 \text{ V}$
- Critical DC electrical parameters specified at elevated temperature
- High performance trench technology for extremely low $R_{DS(ON)}$
- 175°C maximum junction temperature rating



Absolute Maximum Ratings $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Ratings	Units
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	30	V
V_{GSS}	Gate-Source Voltage	± 20	V
I_D	Drain Current – Continuous (Note 1)	80	A
	– Pulsed (Note 1)	240	
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	68	W
	Derate above 25°C	0.45	
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-65 to +175	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristics

$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction-to-Case	2.2	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	62.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$

Package Marking and Ordering Information

Device Marking	Device	Reel Size	Tape width	Quantity
FDB6670AL	FDB6670AL	13"	24mm	800 units
FDP6670AL	FDP6670AL	Tube	n/a	45

Electrical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
--------	-----------	-----------------	-----	-----	-----	-------

Drain-Source Avalanche Ratings (Note 1)

W_{DSS}	Single Pulse Drain-Source Avalanche Energy	$V_{DD} = 15\text{ V}, I_D = 80\text{ A}$			114	mJ
I_{AR}	Maximum Drain-Source Avalanche Current				80	A

Off Characteristics

BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\ \mu\text{A}$	30			V
$\frac{\Delta BV_{DSS}}{\Delta T_J}$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250\ \mu\text{A}$, Referenced to 25°C		24		mV/ $^\circ\text{C}$
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 24\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$			1	μA
I_{GSS}	Gate-Body Leakage	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$			± 100	nA

On Characteristics (Note 2)

$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu\text{A}$	1	1.9	3	V
$\frac{\Delta V_{GS(th)}}{\Delta T_J}$	Gate Threshold Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250\ \mu\text{A}$, Referenced to 25°C		-5		mV/ $^\circ\text{C}$
$R_{DS(on)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 40\text{ A}$ $V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_D = 37\text{ A}$ $V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 40\text{ A}, T_J = 125^\circ\text{C}$		5.2 6.5 7.2	6.5 8.5 9.7	m Ω
$I_{D(on)}$	On-State Drain Current	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 10\text{ V}$	80			A
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS} = 10\text{ V}, I_D = 40\text{ A}$		115		S

Dynamic Characteristics

C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 15\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V},$ $f = 1.0\text{ MHz}$		2440		pF
C_{oss}	Output Capacitance			580		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			250		pF
R_G	Gate Resistance	$V_{GS} = 15\text{ mV}, f = 1.0\text{ MHz}$		1.4		Ω

Switching Characteristics (Note 2)

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 10\text{ V}, I_D = 1\text{ A},$ $V_{GS} = 10\text{ V}, R_{GEN} = 6\ \Omega$		13	23	ns
t_r	Turn-On Rise Time			13	23	ns
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time			42	68	ns
t_f	Turn-Off Fall Time			15	27	ns
Q_g	Total Gate Charge	$V_{DS} = 15\text{ V}, I_D = 40\text{ A},$ $V_{GS} = 5\text{ V}$		24	33	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			7		nC
Q_{gd}	Gate-Drain Charge			9		nC

Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings

I_S	Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current				80	A
V_{SD}	Drain-Source Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_S = 40\text{ A}$ (Note 1)		0.9	1.3	V
t_{rr}	Diode Reverse Recovery Time	$I_F = 40\text{ A},$ $dI_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$		34		nS
Q_{rr}	Diode Reverse Recovery Charge			24		nC

Notes:

1. Pulse Test: Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2.0%

Typical Characteristics

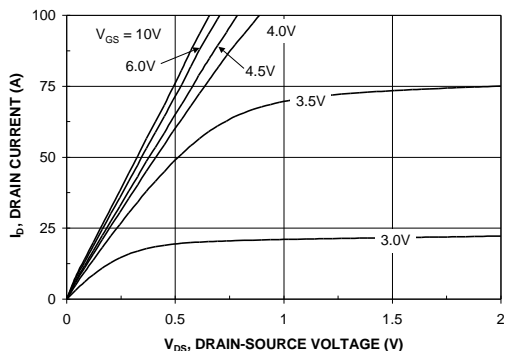


Figure 1. On-Region Characteristics.

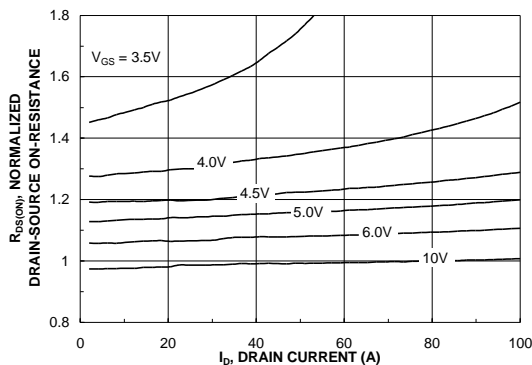


Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage.

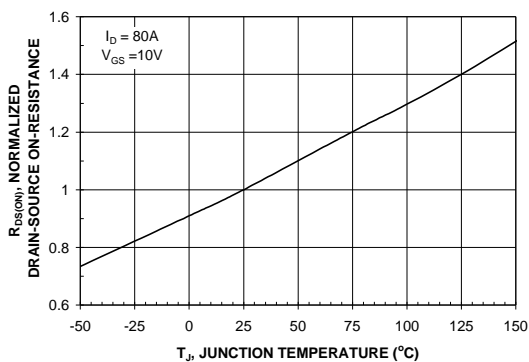


Figure 3. On-Resistance Variation with Temperature.

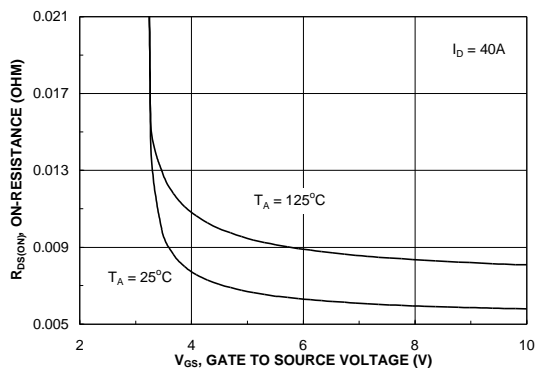


Figure 4. On-Resistance Variation with Gate-to-Source Voltage.

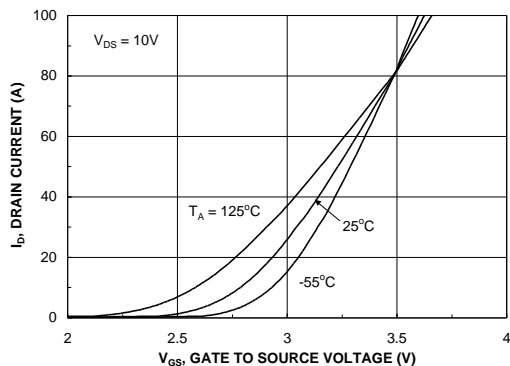


Figure 5. Transfer Characteristics.

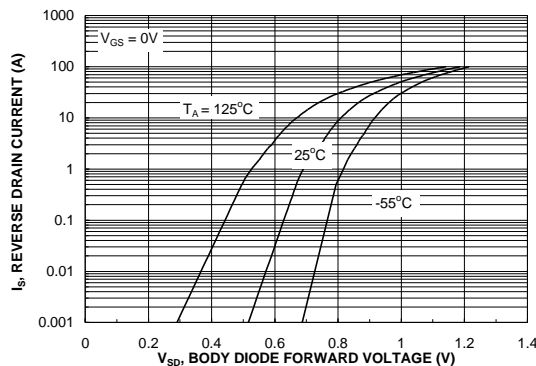


Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature.

Typical Characteristics

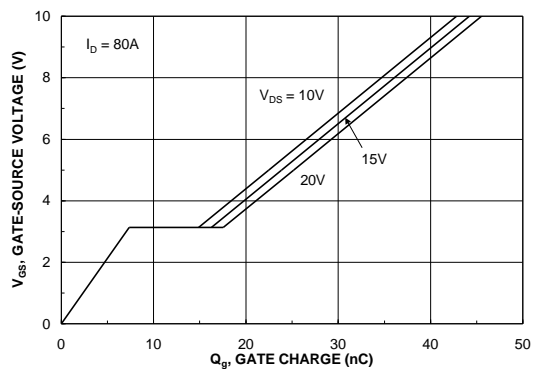


Figure 7. Gate Charge Characteristics.

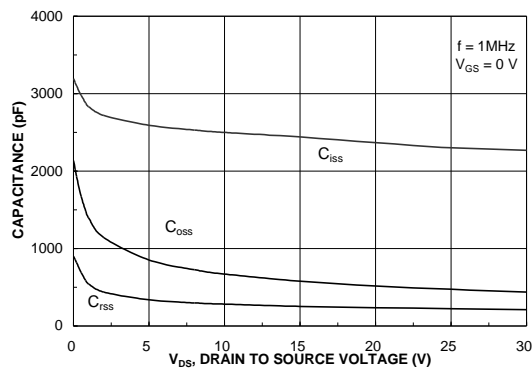


Figure 8. Capacitance Characteristics.

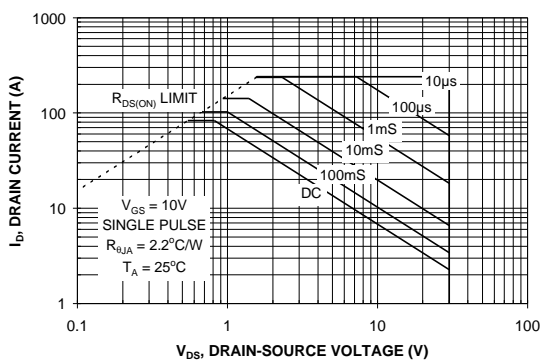


Figure 9. Maximum Safe Operating Area.

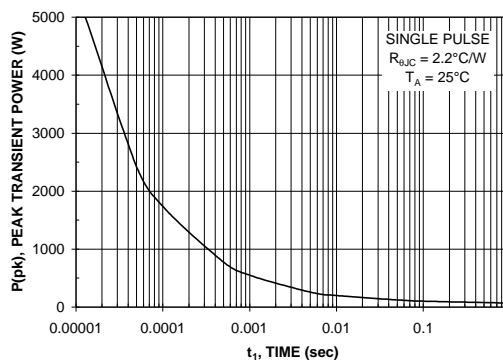


Figure 10. Single Pulse Maximum Power Dissipation.

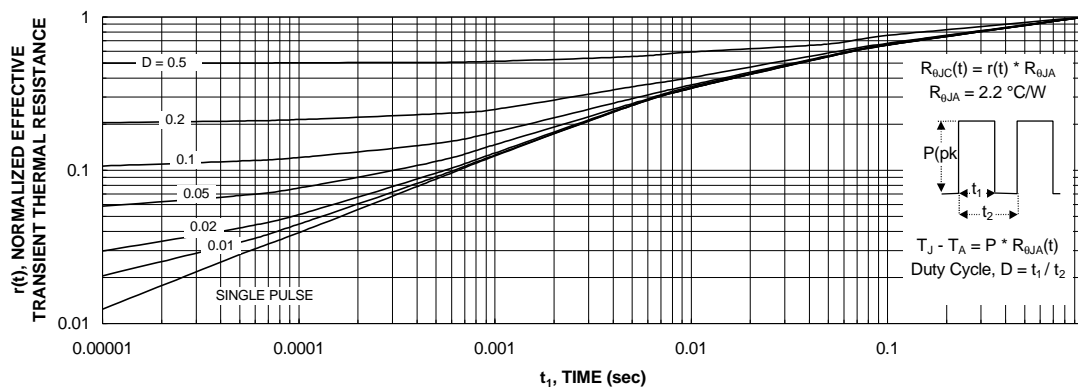


Figure 11. Transient Thermal Response Curve.

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™	FACT™	ImpliedDisconnect™	PACMAN™	SPM™
ActiveArray™	FACT Quiet Series™	ISOPLANAR™	POP™	Stealth™
Bottomless™	FAST®	LittleFET™	Power247™	SuperSOT™-3
CoolFET™	FASTr™	MicroFET™	PowerTrench®	SuperSOT™-6
CROSSVOLT™	FRFET™	MicroPak™	QFET®	SuperSOT™-8
DOME™	GlobalOptoisolator™	MICROWIRE™	QS™	SyncFET™
EcoSPARK™	GTO™	MSX™	QT Optoelectronics™	TinyLogic®
E ² CMOS™	HiSeC™	MSXPro™	Quiet Series™	TruTranslation™
EnSigna™	ꞆC™	OCX™	RapidConfigure™	UHC™
Across the board. Around the world.™		OCXPro™	RapidConnect™	UltraFET®
The Power Franchise™		OPTOLOGIC®	SILENT SWITCHER®	VCX™
Programmable Active Droop™		OPTOPLANAR™	SMART START™	

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
